

속보 자료

투자자 관계 담당:

Ed Lockwood

전무 이사, 투자자 관계 담당

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

언론 관계 담당:

Meggan Powers

전무 이사, 기업 커뮤니케이션

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-TENCOR의 28XX 결함 검수 시스템을 위한 새로운 XP 업그레이드는 향상된 감도, 생산성, 수율 관련 결함 식별 제공

캘리포니아주 밀피타스, 2009. 6. 30. — KLA-Tencor Corporation(NASDAQ: KLAC)은 세계를 선도하는 반도체 및 관련 업체용 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 공급업체로서, 오늘 28XX 광대역 명시야 검수 시스템을 위한 새로운 업그레이드 패키지인 XP를 공개했다. XP 패키지는 검수 시스템에서 표준 IC 디자인 레이아웃 파일, 즉 마스크 습의 마스크 패턴에 사용되는 명령어들에 접근할 수 있도록 최초로 상용화된 제품이다. 이러한 디자인 정보에 접근함으로써 검수 시스템은 회로 내에서 결함 위치 정보를 이용하여 장치 수율에 영향을 끼칠 가능성을 보다 정확하게 추정할 수 있다. 뿐만 아니라 XP는 디자인 파악 웨이퍼 검수의 결과를 이용하여 인쇄 도중 공정 변동에 특히 민감할 수 있는 마스크의 특징을 식별할 수 있다. XP 업그레이드 패키지의 이러한 모든 기능은 기존 28XX 검수 시스템의 감도와 생산성을 향상시키고 결함 결과의 정보 내용을 보강해서, 결함 문제의 식별과 해결을 가속화하는 데 도움을 준다.

"고객 주도 시장에서 칩의 복잡성과 가격 압력이 증가함에 따라 고객들은 근원적 결함 분석을 촉진시키고 생산성을 향상시키며, 보다 빠르고 효율적인 램프(ramp)를 제작할 수 있는 도구를 요구하고 있습니다." KLA-Tencor의 Wafer Inspection Group의 본부장이자 부사장인 Mike Kirk 박사가 밝혔다. "오늘날 첨단 반도체 공장은 193nm 측정 기술을 통해 조명 파장의 거의 1/10 크기, 현재 가산 원자를 이용해 측정할 수 있는 크기의 대상을 인쇄할 수 있는 고급 측정 기술에 대처해야 합니다. 이러한 환경에서 웨이퍼 또는 마스크 여백 패턴의 아주 작은 결함도 수율에 막대한 영향을 끼칠 수 있습니다. 당사의 새로운 XP 패키지는 결함 포착을 최적화하고 수많은 무관 또는 '유사' 결함들 중에서 규칙적인 결함과 기타 수율 관련 결함을 식별하고자 하는 고객의 요구에 대응하기 위한 일보 전진을 의미합니다. 또한 XP는 비용 효율적으로 이러한 기능을 제공합니다. 즉 최첨단 반도체 공장에 이미 설치되어 있는 검수 시스템을 업그레이드하는 것입니다."

새로운 XP 패키지는 검수 결과 또는 검수 시스템의 생산성을 향상시키기 위해 다음과 같은 여러 기능을 포함한다.

- 수율 관련 결함의 우선 포착—검수 도중—결함 지점에서 회로 패턴의 밀도에 기반
- 패턴 그룹에 따라 고도로 국소화된 결함 탐지 한계치를 설정하기 위해 회로 디자인 정보를 사용하여 다이에 포함된 모든 관심 영역에 걸쳐 결함 포착 최적화
- 여백 측정 조건의 조기 탐지(최소 공정 여백이 있는 패턴 유형의 면밀한 관찰을 통해 가능)
- 새로운 계층 또는 새 장치에 대한 검수를 통제하는 광학적, 기계적, 알고리즘 매개변수 설정인 유도체 "레시피"의 오프라인 세대. 여러 레시피 가속화 기능의 하나인 이 기능으로 레시피 설정에 필요한 시간과 인력을 획기적으로 줄일 수 있으며 이로써 검수

시스템 생산성 향상, 소형 로트에도 레시피 최적화 달성, 또는 장치의 신속한 시제품화가 실현된다.

널리 사용되는 281x 및 282x 명시야 검수 시스템의 업그레이드로 제공되는 **XP** 패키지는 다수의 파운드리, 메모리 및 로직 공장에 제공되었으며, 20 개 이상의 기술 논문에 사용되었다.

KLA-Tencor 소개:

KLA-Tencor Corporation(NASDAQ: **KLAC**)은 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 공급업체의 선두 기업으로서, 전 세계 고객들과 협력하여 최첨단 검수 및 측정 기술을 개발하고 있다. 이러한 기술은 반도체, 데이터 저장, 화합물 반도체, 태양 전지 및 기타 관련 나노 전자부품 산업에 사용된다. 업계 표준 제품의 포트폴리오와 세계적인 수준의 엔지니어/연구 팀을 보유하고 있는 **KLA-Tencor** 는 30 년 이상 고객을 위한 우수한 솔루션을 만들고 있다. 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사를 가지고 있는 **KLA-Tencor** 는 전 세계적으로 고객 영업 및 서비스 전담 센터를 운영하고 있다. 보다 자세한 정보는 www.kla-tencor.com 에서 참조할 수 있다. (KLAC-P)

전망:

이 언론 보도 자료에서 발표된 소형 임계 치수 및 딥 서브과장 측정으로 기술 전환이 이루어질 것이라는 예측, 그리고 이러한 기술 전환과 관련된 문제를 **XP** 가 해결할 수 있다는 것과 **XP** 의 기대 성능(결함 포착 강화 기능 및 고객이 **XP** 패키지를 사용함으로써 실현될 장점) 등의 내용은 미래를 전망하는 내용으로, 1995 년 증권민사소송개혁법에 따라 제정된 면책 규정 조항의 적용을 받는다. 이러한 전망에 대한 내용은 현재 정보와 예측을 근거로 이루어졌으며 많은 위험성과 불확실성이 수반되어 있다. 신기술 채택의 지연(비용 또는 성능 문제 또는 다른 이유로 인해) 또는 당사 제품 구현이나 사용에 영향을 주는 예상치 못한 기술적 어려움이나 한계 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 해당 내용에서 예측된 것과 크게 다를 수 있다.

###